

SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 10P PL2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	SEK Low-profile
Komponente	Messerleiste
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Anschlussart	Einpressanschluss
Art der Verbindung	Leiterplatte zu Kabel Leiterplatte zu Leiterplatte
Kontaktanzahl	10
Länge der Pins	5,5 mm

Technische Kennwerte

Steckkontakterien	2
Raster, an schlusseiteig	2,54 mm
Bemessungsstrom	1 A
Isolationswiderstand	>10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤20 mΩ
Grenztemperatur	-55 ... +105 °C
Steck- und Ziehkraft	≤20 N
Anforderungsstufe	2 nach IEC 60603-13
Steckzyklen	≥250

Technische Kennwerte

Prüfspannung U _{eff}	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke	1,6 mm +1,6

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff (PBT)
Farbe Einsatz	grau
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni steckseitig Ni anschlusseiteig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Nickel
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60603-13
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung	F3/I3

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2,92 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140027039

Kaufmännische Daten

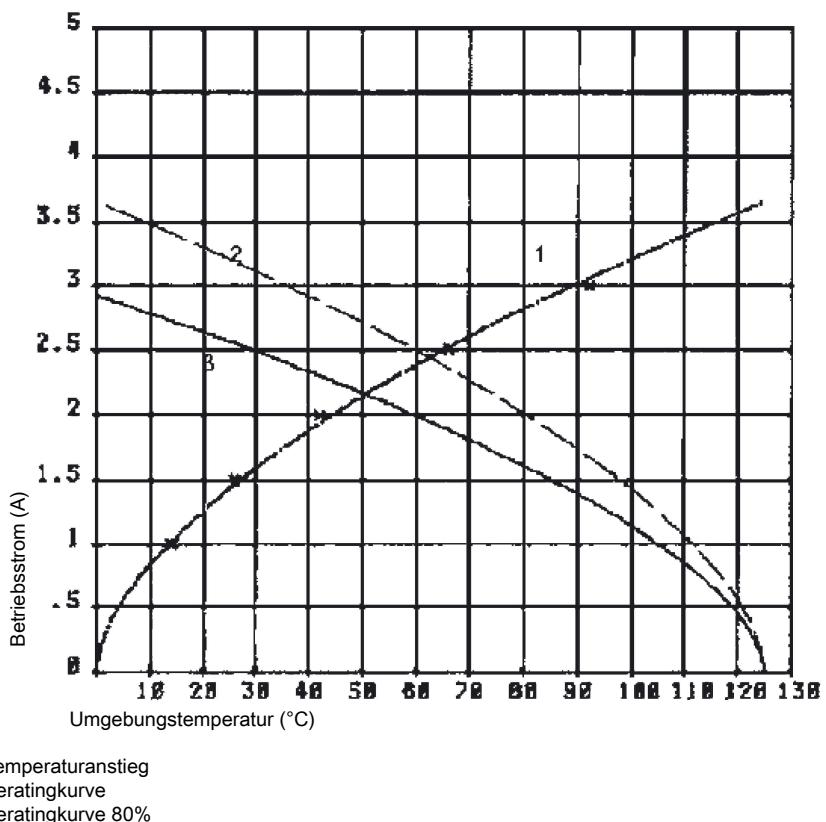
eCl@ss

27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

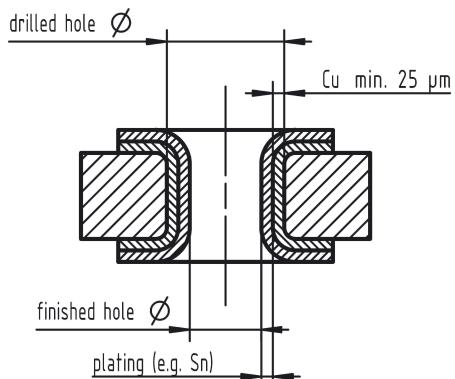
Derating Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente einschließlich Anschlüsse und der Isolerteile begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher für Ströme, die dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung gleichzeitig fließen dürfen, ohne dass die obere zulässige Grenztemperatur überschritten wird.

Mess- und Prüfverfahren nach IEC 60512-5-2



Empfohlener Lochaufbau der Leiterplatte



Tin plated PCB (HAL) acc. to EN 60352-5	Drilled hole Ø	1,15-0,03 mm
	Cu	min. 25 µm
	Sn	max. 15 µm
	plated hole Ø	0,94 - 1,09 mm
Chemical tin plated PCB	Drilled hole Ø	1,15-0,03 mm
	Cu	min. 25 µm
	Sn	min. 0,8µm
	plated hole Ø	1,00 - 1,10 mm
Gold /Nickel plated PCB	Drilled hole Ø	1,15-0,03 mm
	Cu	min. 25 µm
	Ni	3 - 7 µm
	Au	0,05 - 0,12 µm
	plated hole Ø	1,00 - 1,10 mm
Silver plated PCB	Drilled hole Ø	1,15-0,03 mm
	Cu	min. 25 µm
	Ag	0,1 - 0,3 µm
	plated hole Ø	1,00 - 1,10 mm
Copper plated PCB (OSP)	Drilled hole Ø	1,15-0,03 mm
	Cu	min. 25 µm
	plated hole Ø	1,00 - 1,10 mm

Neben der Hot-Air-Level (HAL) Leiterplattenoberfläche werden neue Oberflächen immer bedeutender. Aufgrund ihrer anderen mechanischen Eigenschaften, z. B. Festigkeit und Reibkoeffizient, empfehlen wir die oben genannten Lochaufbauten.